



部品内蔵技術委員会主催 2022年度第一回公開研究会

主催：EPADs技術調査委員会

◆公開研究会のご案内

部品内蔵技術委員会のEPADs技術調査研究会より2022年度第一回目となる公開研究会を開催します。

今回のテーマは「IoT技術の現在と未来」となります。

部品からソリューション、人まで含めたIoTへの取り組みを様々な企業より紹介いただきます。もちろん部品内蔵技術に関わるポイントもご紹介いただきます。

開催日時 2022年6月30日 13:00～17:10

開催方式 WEB研究会(Zoom Webinarシステム利用)

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:00～13:10 オープニング 司会 EPADs技術調査研究会 主査 藤村迅/幹事 梅本清貴

13:10～14:10 「テーマ DX推進に向けたドコモの取り組み ～5G時代からその先の未来へ～」
株式会社 NTTドコモ 高橋 和彦 氏



＜概要＞ニューノーマルとして急速にリモート型社会へと移行する中、自社だけでなく各企業とのコラボレーションも含め、5G・AI・IoT等を活用したDX推進に向けた取り組みを紹介いただきます。また、通信ネットワークにおける6Gに向けた進化をはじめ、5G SA方式を利用した実証や既に商用での社会実装が進むAI、エッジコンピューティング、XRといった要素を組み合わせたソリューションを導入事例とともにご紹介いただきます。

14:15～14:50 「テーマ 社内マイレージシステムにより社員同士のつながりを強化」
株式会社JV-ITホールディングス 猪瀬ルアン 氏



＜概要＞コロナ禍でリモートが進む中社員同士のつながりが希薄になっていませんか？ 転職市場が盛り上がる中、転職していく優秀な社員を引き留められていますか？ 今までの福利厚生ではリモート環境には十分な対応はできません。自社での社員流出対策に取り組む中、編み出した社内マイレージシステムをサービスとして展開しており、その取り組みと効果を紹介いただきます。社員同士の繋がりを強化できるツールをご紹介いただきます。

14:50～15:10 休憩(希望者は講師とZOOMの小部屋にて会話可能です)

15:10～15:45 「テーマ セラミックパッケージを用いた小型IoT機器向け全固体電池」
マクセル株式会社 山田將之 氏



＜概要＞次世代電池の大本命である全固体電池の特徴や性能に関する最先端状況を紹介いただきます。IoT機器に必要な小型化を実現できる全固体電池について、コイン形だけでなくはんだ実装可能なセラミックパッケージにも展開。セットのニーズをいち早く取り入れつつ、電池の特性も向上させる取り組みを紹介いただきます。

15:50~16:25 「テーマ 映像Edge AIで実現する安全、安心」
EDGEMATRIX株式会社 鈴木紀行 氏



＜概要＞“AIをもっと身近に”

NVIDIAのGPU搭載AI BOX+カメラと同社が開発したプラットフォームである“EDGEMATRIX サービス”の活用により、安心、安全な街づくり、省人化、マーケティング情報取得などを実現できるソリューションを紹介いたします。

ベンチャー企業ならではの最先端技術への取り組みをご紹介します。

16:30~17:05 「テーマ IoTに最適な商品開発と部品内蔵技術」
ローム株式会社 津和隆志 氏



＜概要＞IoTに最適な製品の商品化を進めており、そういった製品を紹介いたします。IoTには顧客だけでなく標準化も必要でありそれぞれについて苦労するポイントを説明いたします。

またIoT商品には小型化要求がつきもので、実現するための技術もご紹介いたします。

参加要項

定員 300名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:5,000円、学生会員:1,000円、研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円

名誉会員:無料、賛助会員の社員:5,000円、賛助会員(クーポン利用):無料

非会員一般:15,000円 非会員学生:2,000円 協賛団体会員:5,000円

注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
- ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:銀行振込・クレジットカード決済)
- ③請求書や振込確認後の領収書のご発行は、返信メールのマイページから出力が可能です。
- ④WEBの請求書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
- ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。

*キャンセルポリシー

お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員/賛助/非会員の方

※賛助クーポン使用の場合は「賛助会員(クーポン利用)」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会

E-mail: info@jiep.or.jp

(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)